

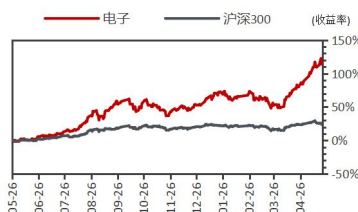
行业及产业

电子

电子布行业具备估值提升潜力
——电子行业跟踪报告

强于大市

一年内行业指数与沪深300指数对比走势：



资料来源：聚源数据，爱建证券研究所

相关研究

《电子行业专题报告：AI Glasses 开启智能穿戴时代》2026-05-15

《电子行业周报：AI 驱动需求爆发，半导体产业链持续受益》2026-05-18

《电子行业专题报告：DeepSeek V4 发布国产算力乘风起航》2026-05-14

《电子行业周报：NVIDIA 入局 Corning 锁定光互联核心产能，筑牢 AI 算力供应链根基》2026-05-11

《电子行业周报：HBM 迭代筑牢 Samsung AI 芯片壁垒》2026-05-06

证券分析师

许亮

S0820525010002

0755-83562506

xuliang@ajzq.com

联系人

朱俊宇

S0820125040021

021-32229888-25520

zhujunyu@ajzq.com

投资要点：

- **事件：**2026年5月13日，全球玻纤龙头中国巨石发布公告称，公司拟通过全资孙公司巨石集团淮安有限公司，投资44.31亿元在江苏淮安建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线项目。该项目建设周期为1.5年，产品将以7628型厚布、薄布及超薄布为主，兼顾当前供需紧张的普通电子布市场与未来高增长的高端应用领域。此次扩产正值电子布行业高景气周期。根据卓创资讯数据，2026Q1，行业主流的7628型号电子布季度含税均价约为5.2元/米，同比+28.6%，环比+21.8%；自2025Q4启动本轮涨价以来，累计涨幅已达49.4%。
- **电子布即电子级玻璃纤维布，是覆铜板核心增强基材，也是印制电路板材料成本的重要构成部分。**它采用单丝直径9 μ m及以下的超细玻璃纤维电子纱经纬精密织造而成，材质结构致密稳定，具备出色的耐高温、耐酸碱耐腐蚀性能，同时兼具优良的电气绝缘性与高强度力学特性，绝缘可靠、尺寸稳定性佳，能够适配高端电路板的严苛生产工艺。按厚度规格，电子布可划分为厚布、薄布、超薄布及极薄布：厚布（>100 μ m）采用单丝直径9 μ m的粗纱织造，下游主要应用于低端手机、家电及建材领域；薄布（36-100 μ m）采用单丝直径5-7 μ m的细纱织造，广泛应用于智能手机、服务器、汽车电子等主流领域；超薄布（28-35 μ m）与极薄布（<28 μ m）技术壁垒较高，分别采用单丝直径<5 μ m的超细纱与极细纱织造，广泛应用于高端智能手机及IC载板等领域。
- **AI算力需求爆发，电子布行业进入量价齐升的高景气周期。**据TrendForce数据，Google、AWS等全球头部云厂商资本开支2023-2025年复合增长率达63.7%，2025年达4627亿美元，预计2026年将进一步增长至8300亿美元。云厂商大规模投入推动AI服务器市场高速扩容，弗若斯特沙利文数据显示，全球AI服务器出货量2020-2024年复合增长率达45.2%，2024年达200万台，预计2030年将增长至650万台。AI服务器对布线密度与信号传输能力要求大幅提升，推动PCB向高层数（12-30层）、高密度（500-800点/平方英寸）、超低损耗（Dk $\leq$ 3.6、Df $\leq$ 0.005）方向迭代。覆铜板作为PCB第一大成本项（占比27.3%），其性能直接决定PCB核心指标，下游升级倒逼CCL加速向高频高速、超低损耗产品转型。电子布是CCL的核心增强基材，其织物结构、纤维规格与理化指标直接决定CCL的介电常数、热稳定性及平整度，AI算力产业的爆发正从终端向上游传导，全面带动电子布行业需求升级与产品结构高端化。
- **全球电子布市场规模持续上扬。**据共研网数据，2024年全球电子布市场规模为25亿美元，预计2033年将达到48亿美元，2024-2033年复合增长率为7.5%。从国内电子布需求来看，华经产业研究院数据显示，2024年中国覆铜板行业电子布总需求量为35亿米/年，2025年需求量预计增长至37亿米/年，同比+5.7%。伴随AI服务器PCB向高层数、高密度、超低损耗方向迭代，下游高端化升级趋势对上游CCL的材料纯度、介电性能、耐热性及工艺精度提出了更为严苛的要求，推动行业加速向高频高速、超低损耗CCL产品升级。电子布是制作覆铜板的核心基材，其织物结构、纤维规格与理化指标决定CCL的介电常数、热稳定性及平整度。
- **投资建议：**AI算力产业爆发正驱动电子布行业进入历史性高景气周期，供需缺口持续扩大，价格上涨弹性及持续性远超市场预期。电子布作为覆铜板核心增强基材，是PCB材料成本的重要构成项。同时随着下游CPU/GPU封装、DDR高速内存、AI服务器主板等核心部件，对具备低热膨胀系数、低介电常数及超低传输损耗特性的电子布需求持续增长。电子布正从传统绝缘基材向功能性材料加速演进，相关上市公司具备估值提升的潜力。
- **风险提示：**1) AI算力需求不及预期风险；2) 产能扩张超预期风险；3) 原材料价格波动风险；4) 高端产品技术迭代风险；5) 宏观经济波动风险。

目录

1. 中国巨石拟 44.31 亿元投建电子纱电子布一体化产线	4
1.1 电子布是 PCB 生产制造中的核心增强基材	4
1.2 AI 算力产业发展带动电子布行业需求升级	5
1.3 电子布市场从传统绝缘基材向功能性材料加速演进	7
2. 风险提示	8

图表目录

图表 1：电子布产品应用供应流程.....	4
图表 2：电子布可分为厚布、薄布、超薄布和极薄布.....	5
图表 3：全球人工智能的迭代升级.....	5
图表 4：2026 年全球云厂商资本开支将达到 8300 亿美元.....	5
图表 5：全球 AI 服务器市场规模.....	6
图表 6：AI 服务器 PCB 在关键参数上较普通 PCB 实现了显著升级.....	6
图表 7：覆铜板是 PCB 的核心基材，占比 27.3%.....	7
图表 8：AI 服务器升级对 CCL 提出更高的要求.....	7
图表 9：全球电子布市场规模.....	8
图表 10：中国覆铜板行业电子布总需求量.....	8
图表 11：电子布从传统绝缘基材向功能性材料加速演进.....	8

1. 中国巨石拟 44.31 亿元投建电子纱电子布一体化产线

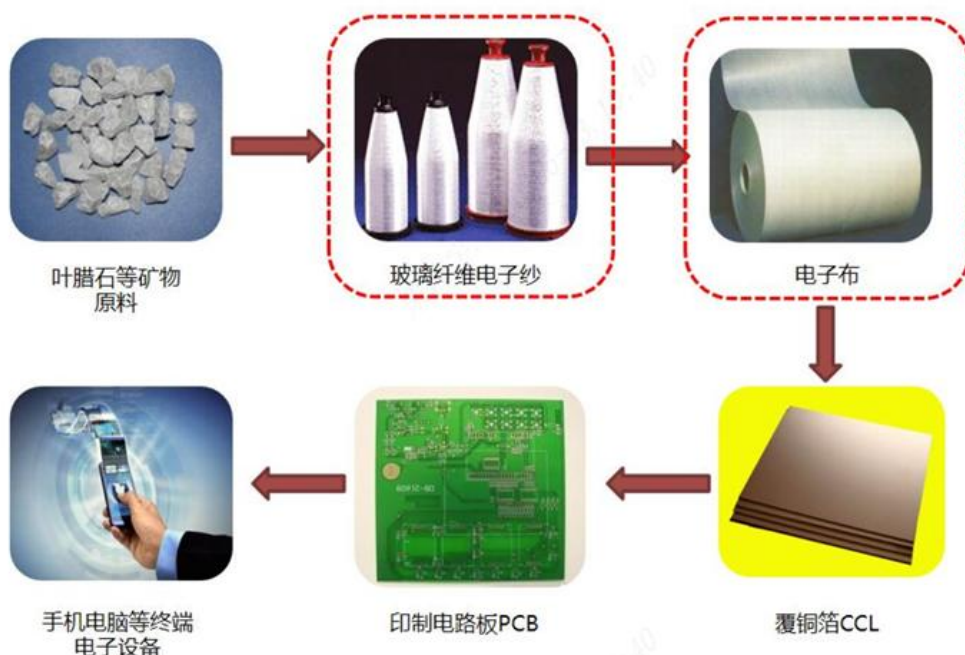
事件：2026 年 5 月 13 日，全球玻纤龙头中国巨石发布公告称，公司拟通过全资孙公司巨石集团淮安有限公司，投资 44.31 亿元在江苏淮安建设年产 5 万吨电子纱暨 3.2 亿米电子布生产线项目。该项目建设周期为 1.5 年，产品将以 7628 型厚布、薄布及超薄布为主，兼顾当前供需紧张的普通电子布市场与未来高增长的高端应用领域。

此次扩产正值电子布行业高景气周期。根据卓创资讯数据，2026Q1，行业主流的 7628 型号电子布季度含税均价约为 5.2 元/米，同比+28.6%，环比+21.8%；自 2025Q4 启动本轮涨价以来，累计涨幅已达 49.4%。

1.1 电子布是 PCB 生产制造中的核心增强基材

电子布即电子级玻璃纤维布，是 CCL（覆铜板）核心增强基材，也是 PCB（印制电路板）材料成本的重要构成部分。它采用单丝直径 9 微米及以下的超细玻璃纤维电子纱经纬织造而成，材质结构致密稳定。该材料拥有出色的耐高温性能、耐酸碱耐腐蚀特性，同时兼具优良的电气绝缘性与高强度力学性能，绝缘可靠、尺寸稳定性佳，适配高端电路板严苛生产工艺。凭借诸多优异综合特性，电子布现已广泛应用于通讯设备、消费电子、新能源工控、汽车电子等各类电子产品领域，是电子电路产业的基础关键材料。

图表 1：电子布产品应用供应流程



资料来源：宏和电子 2025 年报，爱建证券研究所

按厚度规格，电子布可划分为厚布、薄布、超薄布及极薄布。其中，厚布厚度 $>100\mu\text{m}$ ，采用单丝直径 $9\mu\text{m}$ 的粗纱织造，下游主要应用于低端手机、家电及建筑建材领域；薄布厚度 $36\text{-}100\mu\text{m}$ ，采用单丝直径 $5\text{-}7\mu\text{m}$ 的细纱织造，广泛覆盖智能手机、服务器、汽车电子等主流市场；超薄布（ $28\text{-}35\mu\text{m}$ ）与极薄布（ $<28\mu\text{m}$ ）技术壁垒较高，分别采用单丝直径 $<5\mu\text{m}$ 的超细纱与极细纱织造，被广泛应用于高端智能手机及 IC 载

板等领域。

图表 2：电子布可分为厚布、薄布、超薄布和极薄布

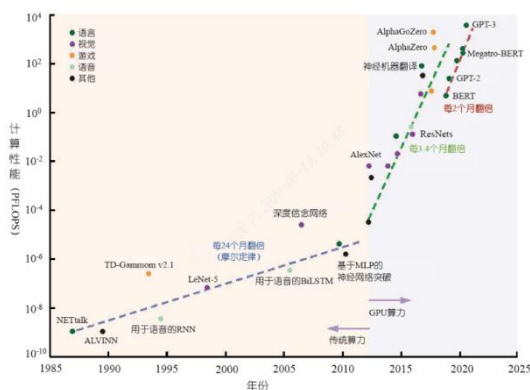
产品档次	产品名称	厚度 (μm)	常用 IPC 代号	电子纱	电子纱厚度 (μm)	用途
高端	极薄布	<28	1037/1027/1017 /1000/101/1015	极细纱	<5	高端智能手机、IC 载板
高端	超薄布	28-35	106/1067/1035/104	超细纱	<5	高端智能手机、IC 载板
中端	薄布	36-100	1080/2116/ 1078/1086	细纱	5-7	智能手机、服务器、 汽车电子材料
低端	厚布	>100	7628	粗纱	9	低端手机、家电、 建筑建材

资料来源：智研咨询，爱建证券研究所

1.2 AI 算力产业发展带动电子布行业需求升级

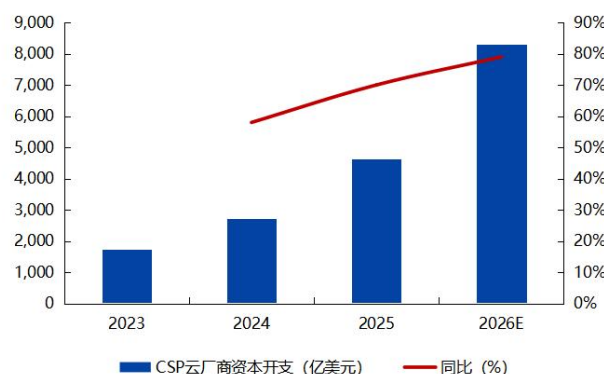
随着全球通用人工智能技术加速演进，人工智能训练和推理需求持续扩大，直接拉动全球头部科技与云服务厂商资本开支呈爆发式增长。据 TrendForce 数据，Google、AWS、Meta、Microsoft 等云厂商的资本开支从 2023 年的 1726 亿美元增长至 2025 年的 4627 亿美元，2023-2025 年复合增长率达 63.7%；该机构进一步预测，2026 年上述全球头部厂商资本开支预计将达到 8300 亿美元。

图表 3：全球人工智能的迭代升级



资料来源：中国计算机学会，爱建证券研究所

图表 4：2026 年全球云厂商资本开支将达到 8300 亿美元



资料来源：TrendForce，爱建证券研究所

云厂商在服务器领域的开拓创新，有望推动 AI 服务器市场持续向好。弗若斯特沙利文数据显示，全球 AI 服务器市场规模从 2020 年的 50 万台增长至 2024 年的 200 万台，2020-2024 年复合增长率达 45.2%；该机构进一步预测，2030 年全球 AI 服务器市场规模或将增长至 650 万台，2025-2030 年复合增长率为 21.2%。

图表 5：全球 AI 服务器市场规模



资料来源：弗若斯特沙利文，爱建证券研究所

近年来 AI 服务器对布线密度与信号传输能力要求不断提高，行业借助高层数 PCB 增加叠层，利用内层空间布设更多线路、缩短信号路径，同时依托高密度 HDI 技术缩小线宽线距，提升单位面积布线容量。

图表 6：AI 服务器 PCB 在关键参数上较普通 PCB 实现了显著升级

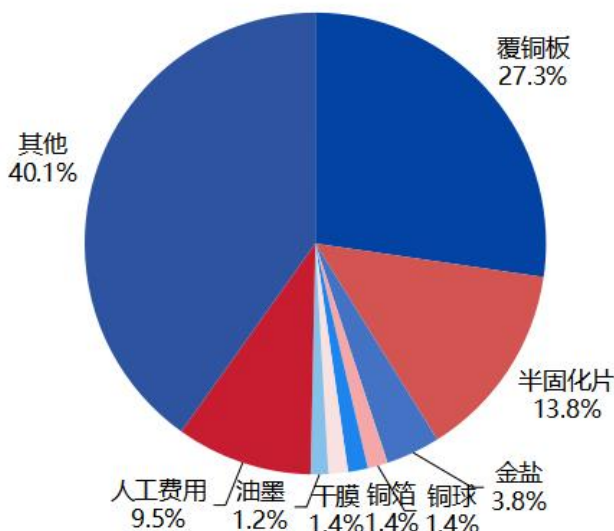
	普通 PCB	AI 服务器 PCB
布线密度	100-200 点/平方英寸	500-800 点/平方英寸
布线层数	多为 4-8 层	普遍在 12-30 层
过孔直径	约 0.3-0.5mm	仅 0.1-0.2mm，甚至采用 0.05mm 的微过孔
核心布线技术	常规布线，无特殊高密度技术要求	高密度互连 (HDI) 技术
材料性能	普通 FR-4 环氧树脂玻璃布基板，成本低、加工简单，介电常数 $Dk \approx 4.2-4.5$ ，损耗因子 $Df \approx 0.02$	采用 PTFE、罗杰斯 RO4350B 等超低损耗基材，介电常数 Dk 低至 3.0-3.6，损耗因子 $Df \leq 0.005$

资料来源：iPCB，爱建证券研究所

注：低 Dk/Df 材料显著降低高速信号传输衰减，保障海量数据无延迟、无失真传输

覆铜板 (CCL) 是 PCB 生产的核心基材，决定了 PCB 的信号传输、耐热及稳定性能。据中商情报网统计，PCB 原材料主要包含覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜、油墨等品类，其中覆铜板为第一大成本项，占 PCB 总成本比例达 27.3%。

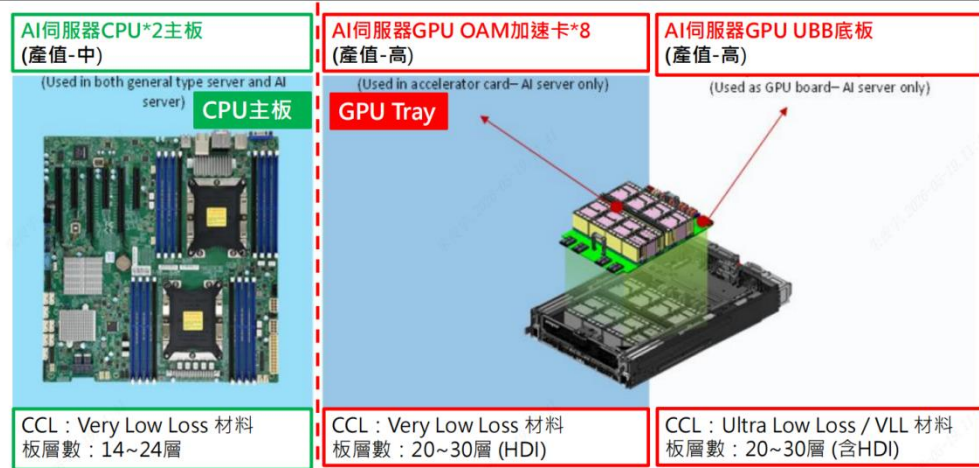
图表 7：覆铜板是 PCB 的核心基材，占比 27.3%



资料来源：中商情报网，爱建证券研究所

伴随 AI 服务器 PCB 向高层数、高密度、超低损耗方向迭代，下游高端化升级趋势对上游 CCL 的材料纯度、介电性能、耐热性及工艺精度提出了更为严苛的要求，推动行业加速向高频高速、超低损耗 CCL 产品升级。电子布是制作覆铜板的核心基材，其织物结构、纤维规格与理化指标决定 CCL 的介电常数、热稳定性及平整度。

图表 8：AI 服务器升级对 CCL 提出更高的要求



资料来源：联茂电子公司公告，爱建证券研究所

1.3 电子布市场从传统绝缘基材向功能性材料加速演进

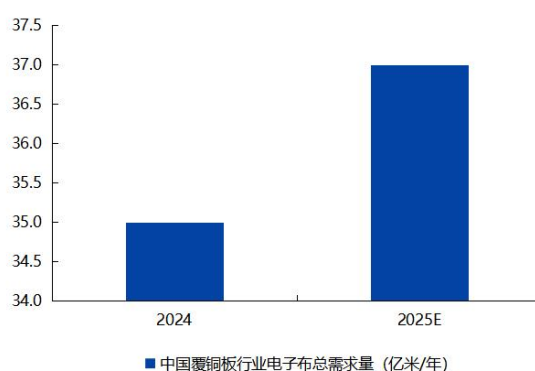
全球电子布市场规模持续上扬。据共研网数据，2024 年全球电子布市场规模为 25 亿美元，预计 2033 年将达到 48 亿美元，2024-2033 年复合增长率为 7.5%。从国内电子布需求来看，华经产业研究院数据显示，2024 年中国覆铜板行业电子布总需求量为 35 亿米/年，2025 年需求量预计增长至 37 亿米/年，同比+5.7%。

图表 9：全球电子布市场规模



资料来源：共研网，爱建证券研究所

图表 10：中国覆铜板行业电子布总需求量



资料来源：华经产业研究院，爱建证券研究所

随着 5G 通信、人工智能与新能源汽车产业的快速发展，电子布正从传统绝缘基材向功能性材料加速演进。下游 CPU/GPU 封装、DDR 高速内存、AI 服务器主板等核心部件，对具备低热膨胀系数、低介电常数及超低传输损耗特性的电子布需求持续增长。

图表 11：电子布从传统绝缘基材向功能性材料加速演进

Application		Device/ component	Substrate type	Required performance	Glass fiber type		
					High-end	Middle-end	
Telecom/ infra- structure	• Base stations • Data center Switch/Router Server • AI servers	Processor controller	Semiconductor package substrate	CPU/GPU/ASIC	Low CTE	T	E
				NAND memory	Low CTE	T	E
				DDR memory	Low dielectric tangent	NE /NER	E
		Motherboard	Servers(AI, Geneal)		Low dielectric tangent	NE /NER /NEZ	E
			Switch(Core, AI)		Low dielectric tangent	NE /NER	E
			Network card (NIC)		Low dielectric tangent	NE /NER	E
Edge equipment	Smartphone Tablet Mobile PC Edge AI device	Processor	Semiconductor package substrate	AP·CPU/NPU	Low CTE	Ultra-thin T, T	Ultra-thin E
		Non-volatile memory		NAND memory	Low CTE	Ultra-thin T	Super ultra-thin E
		Volatile memory		DDR memory	Low CTE	Ultra-thin T (Smartphone)	
		Volatile memory		DDR memory	Low dielectric tangent	NE(PC)	
		Motherboard	Motherboard		Low dielectric tangent	Ultra-thin NE New	Ultra-thin E
		Wireless communication	RF package substrate		Low dielectric tangent	Ultra-thin NE	Ultra-thin E
	Desktop· Laptop PC	CPU·memory	Semiconductor package substrate	CPU/GPU/NPU	Low CTE	T	E
		Motherboard		DDR memory	Low dielectric tangent	NE(PC)	E
	AR/VR·Drone	Advanced SoC	Semiconductor package substrate		Low CTE	T	Ultra-thin E
		Advanced SoC	Semiconductor package substrate		Low CTE	T	E
Automobile	EV·ADAS	Millimeter wave radar	Module board		Low dielectric tangent	Ultra-thin NE	E

资料来源：Nittobo，爱建证券研究所

2. 风险提示

- 1) AI 算力需求不及预期风险：**若全球 AI 技术发展放缓、云厂商资本开支下降或 AI 服务器出货量不及预期，将导致高端电子布需求增速放缓，进而影响行业景气度和公司业绩。
- 2) 产能扩张超预期风险：**截至 2025 年底，全球电子玻纤在建/拟建项目投资达 133.8 亿元。若行业内其他企业大规模扩产电子布产能，或日本丰田织布机交付周期缩短，可能导致供需格局逆转，电子布价格出现大幅下跌。
- 3) 原材料价格波动风险：**纯碱、天然气等原材料价格上涨将增加公司生产成本，若成本无法向下游传导，将压缩公司毛利率。
- 4) 高端产品技术迭代风险：**若公司无法跟上高端电子布的技术发展趋势，或在

Low-Dk、Low-CTE 等特种电子布领域的技术突破不及预期，可能失去高端市场份额。

5) 宏观经济波动风险：宏观经济下行将影响消费电子、汽车电子、通信设备等下游行业需求，进而对电子布行业产生不利影响。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15% 之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5% 之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。